

## 金刚石-铜复合热沉片

金刚石/铜复合材料是一种先进的热管理材料，  
它兼具金刚石极高的热导率和金属铜优良的加工性、可镀性。

该材料具有优异的热物理性能，其热膨胀系数可调，  
能够与半导体芯片材料（如砷化镓GaAs、氮化镓GaN、碳化硅SiC 等）  
实现良好的热匹配，  
有效解决高功率密度电子器件（如第三代半导体芯片）的散热问题。

它是传统热沉材料（如Cu/W、Cu/Mo等）的理想升级替代品，  
在高功率、高频率、高集成度的特殊电子应用领域前景广阔。

DIAMOND COPPER  
HEAT SINK

CUFENG



## 核心优势

### 极速散热 性能不掉线

热导率高达600–800 W/m·K，  
迅速导出芯片热量，  
确保高功率器件持续高效运行。

### 热膨胀匹配 告别热应力损伤

热膨胀系数可调，与GaAs、GaN、  
SiC 等半导体较好匹配，  
大幅提升器件可靠性与寿命。

### 易加工、好集成 支持定制化设计

表面可镜面抛光、激光打孔、  
丝印刻蚀，支持焊接与封装，  
快速融入您的产品体系。

### 高温稳定 无惧严苛环境

在300°C高温下仍保持性能稳定，  
适用于车载、航天、工业等  
高要求场景。

## 技术参数

型号	密度 (g/cm <sup>3</sup> )	热导率 (W/m · K)	热膨胀系数 (× 10 <sup>-6</sup> /K)	抗弯强度 (MPa)
CF-600	5.5	600	8	≥300
CF-700	5.3	700	7	≥300
CF-800	5.1	800	6	≥300